

International Student Contest

INTERCONNECTION TECHNIQUES IN ELECTRONICS

TIE 2010

Qualification Stage,

Timișoara, November 27th 2009



BAREM CORECTURA

CONCURENT.....

Nr.	Cerinta	Punctaj acordat	Punctaj obtinut
1	Simbol PIC (- 0,5pct / pin in plus)	9	
	desen + nume	1	
	16 pini, denumiți ca în schemă / datasheet (16 x 0,25 pct)	4	
	alimentare 4 pini (4 x 1)	4	
2	Asocieri PIC	6	
	asociere amprentă DIP40	1	
	asociere 20 terminale (20 x 0,25 pct)	5	
3	Simbol Display	7	
	desen contur + nume	1	
	desen segmente	2	
	desen puncte zecimală	1	
	12 pini (12 x 0,25 pct)	3	
4	Amprentă display	10	
	12 paduri cu gaura \geq 0,6mm (12 x 0,25 pct)	3	
	2,54 mm intre pini (pe randuri) (- 0,5pct / distanță greșită)	2	
	15,24mm intre randuri	1	
	gabarit 19 x 50,3 mm centrat fata de pini (3 x 1 pct, , -1pct pt. vopsea peste paduri)	3	
	marcaj de pozitie	1	
5	Asocieri display	4	
	asociere simbol-amprentă	1	
	asocieri terminale:CC=12, 9, 8, 6. Segmente=11, 7, 4, 2, 1, 10, 5, 3 (12 x 0,25 pct)	3	
6	Amprentă conector SMA	12	
	3 paduri pe top + 2 paduri pe bottom (1 + 1 dacă se poate lipi pe top și bottom)	2	
	paduri masă \geq 1 x 4 mm (1 + 1)	2	
	pad semnal \geq 1,27 x 4 mm (1 + 1, doar dacă e SMD)	2	
	distanță 2,67mm intre paduri (totul sau nimic)	4	
	gabarit 11,43 x 6,35mm (1 + 1 pct; -1pct pt. vopsea peste paduri)	2	
7	Asocieri SMA	6	
	asociere simbol-amprentă	1	
	asociere pin 1 semnal + 4 pini masa (1 + 1x4)	5	
8	Amprentă soclu baterie	4	
	2 paduri cu gaura \geq 1 mm (2 x 0,5 pct)	1	
	distanță 51,99 mm între paduri	1	
	gabarit 57 x 16,89 mm (0,5 + 0,5 pct; -0,5 pct pt. vopsea peste paduri)	1	
	marcaj bornă +	1	
9	Asocieri soclu baterie	2	
	asociere simbol-amprentă	1	
	asociere 2 pini (conform marcajului, dacă există)	1	

10	Alimentare 4.5 V (orice soluție)	10	
11	Asocieri amprente	5	
	4017 in capsula SO16	1	
	100nF in capsula 0805	1	
	orice amprente pentru restul componetelor (- 0,5 pct/ asociere lipsă sau greșită)	3	
12	Utilizare 3 magistrale : RE[0:1], RD[0:7], SEL[1:8] (3 x 1pct. magistrală+1pct. denumire)	6	
13	Corectitudine schema electrica	50	
	- Lipsa/surplus IC sau display	-10	
	- Lipsa/surplus componente discrete	-5	
	- conexiuni lipsa sau gresite	-5	
	- valori lipsă sau greșite	-3	
	- simboluri gresite	-3	
14	Transfer layout (doar dacă toate componentele și conexiunile s-au transferat corect)	3	
15	Contur placa	4	
	contur rectangular	1	
	colturi rotunjite	1	
	dimensiune minimă necesară (încadrarea componentelor majore fără spații libere inutile)	2	
16	Reguli	6	
	latime trasee semnal: 0,25 mm	1	
	latime trasee VCC+GND: 0,4 mm (1 + 1 pct.)	2	
	spatiere trasee: 0,25mm	1	
	spatiere traseu-pad: 0.3mm	2	
17	Plasare componente (se consideră doar cele din interiorul conturului)	11	
	display si baterie pe top (1 + 1)	2	
	cuartz si condensatoare langa PIC (1 + 1)	2	
	decuplari langa pinii de alimentare (1 + 1)	2	
	SMA langa PIC	2	
	restul componentelor in interiorul conturului (-0.5pct/greseala)	3	
18	Traseu SMA-PIC pe un singur nivel, lungime max. 30mm (totul sau nimic)	10	
19	Bucla masa pentru cuartz (totul sau nimic)	10	
20	Plan masa sub PIC (totul sau nimic)	10	
21	Condensatoare de decuplare conectate direct la plan (fără via: 3 + 3)	6	
22	Rutare	5	
	orizontal pe top, vertical pe bottom (dacă nu e rutat se verifică configurarea)	1	
	rutare parțială / totală	2 / 4	
23	Marcaj SMA	4	
	marcaj în masca de lipire (top sau bottom mirror)	2	
	cod 9650-1113-017	2	
24	Generare CAM : top, bot, smtop,smbot,outline , drill (6 x 1 pct; -1pct/fisier in plus)	6	
	Nerespectare succesiunii de proiectare	-50	

Comisie corecțura..... Student.....

TOTAL **200**